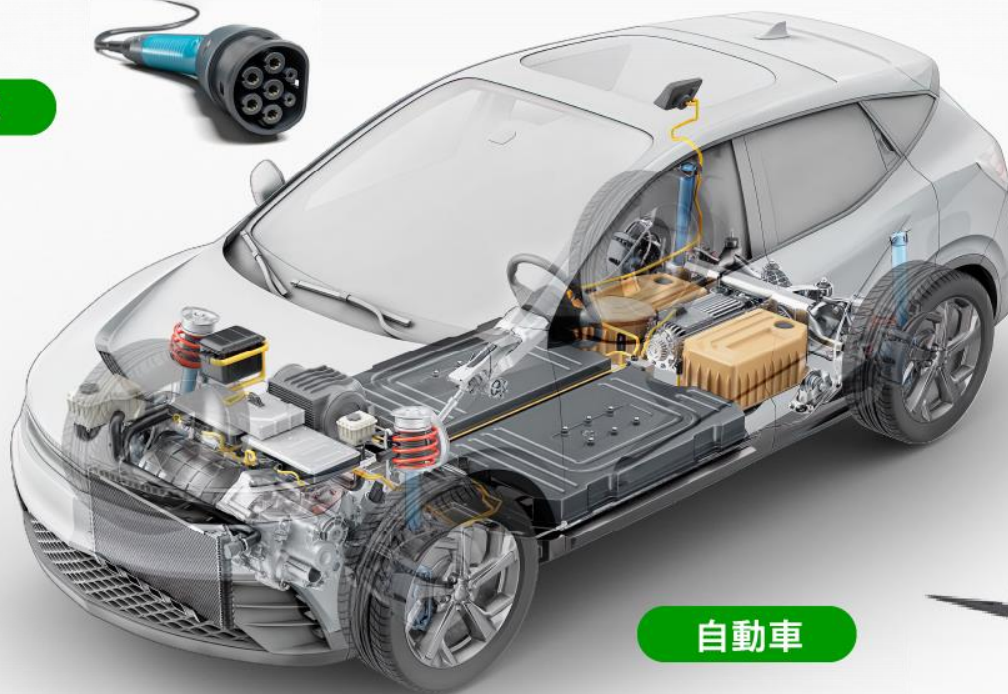


プリント配線板は 多くの社会インフラを支えている



スマホ



自動車

医療機器



飛行機



電子カード



プリント配線板製品の種類

対象の技術名をクリックすると、企業一覧をご確認いただけます。



リジッド基板

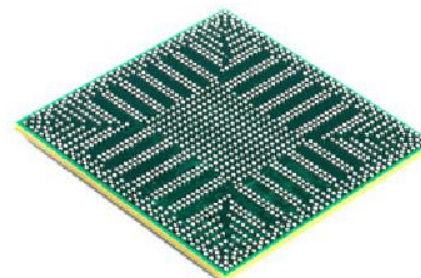
片面・両面基板
多層基板

フレックスリジッドプリント配線板



フレキシブル基板

片面・両面基板
多層基板



半導体パッケージ基板

有機基板
無機基板
その他

プリント配線板・その他



部品内蔵基板

電子部品内蔵基板
部品内蔵基板その他

プリント配線板ができるまで

～材料・加工工程・装置～

基板材料

銅張積層板・関連材料

銅はく/金属はく

カバーフィルム

接着シート/フィルム

その他

基板設計

パターン設計

シミュレーション評価

プリント配線板設計その他

資機材／製造装置

積層・プレス(多層化)

ドリル・レーザ穴あけ

めっき加工

パターン形成

ソルダーレジスト形成

シンボル形成

外形加工

最終表面処理

実装工程

その他

最終検査・分析

製品検査

試験・評価・分析

製造工程詳細は次ページ

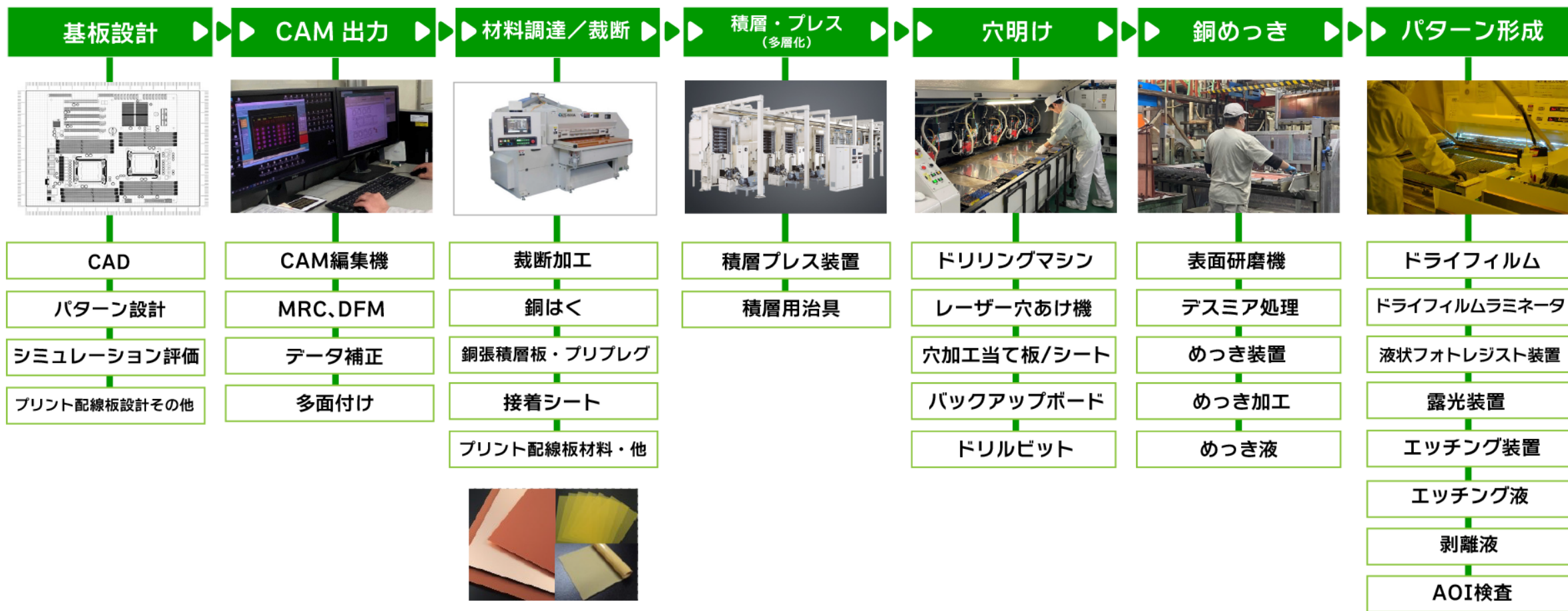


プリント配線板製造工程(両面・多層)

画像提供：(株)メイコー様、ショーダテクノロン(株)様、(株)レゾナック様、北川精機(株)様、
(株)ちの技研様

対象のプロセス名をクリックすると、企業一覧をご確認いただけます。

プロセス開始



次工程へ

プリント配線板製造工程(両面・多層)

画像提供：(株)ちの技研様、メイコー(株)様、ピアメカニクス(株)様、大船企業日本(株)様、ヤマハファインテック(株)様、(株)SCREEN PE ソリューションズ様、J-RAS (株)様 (株)フィッシャー・インストルメンツ様

対象のプロセス名をクリックすると、企業一覧をご確認いただけます。

プロセスエンド



プリント配線板製品出展者

出展者名をクリックすると詳細が確認いただけます。



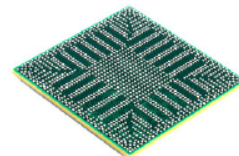
リジッド基板

岩手大学 理工学部 : 3A-06
(株)京写 : 6A-09
(株)大日光・エンジニアリング : 5i-08
(株)伸光製作所 : 6B-05
(株)ダイワ工業 : 6A-07
PCBGOGO : 6E-14
(株)アイン : 6F-11
伊原電子工業(株) : 5i-09
広東駿垂電子科技股份有限公司 : 6C-03
(株)松和産業 : 5i-06
China Circuit Technology (Shantou) Corporation : 6G-01
フジブリグループ(株) : 2E-11
(株)メイコー : 6B-06
FICT (株) : 6E-06
KFE Hong Kong (株) : 6C-04
Jiangsu Provision Electronics CO., LTD. : 6F-07
日本ミクロン(株) : 6E-07



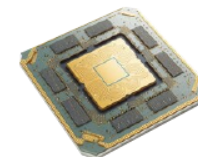
フレキシブル基板

圓裕企業(株) : 5i-02
沖電線(株) : 5H-04
Korea Electronics Technology Institute : 5H-02
PCBGOGO : 6E-14
山下マテリアル(株) : 5H-01
KFE Hong Kong (株) : 6C-04
(株)松和産業 : 5i-06



半導体パッケージ基板

FICT (株) : 6E-06
(株)シミズ : 6E-09
Jiangsu Provision Electronics CO., LTD. : 6F-07
日本ミクロン(株) : 6E-07
(株)メイコー : 6B-06
日東紡績(株) : 6F-01
アズワン(株) : 6E-08
アテネ(株) : 2H-08



部品内蔵基板

昭立電気工業(株) : 4B-12
Jiangsu Provision Electronics CO., LTD. : 6F-07
ディジインターナショナル(株) : 5C-12
(株)シミズ : 6E-09
(株)メイコー : 6B-06

フレックスリジッドプリント配線板

圓裕企業(株) : 5i-02
広東駿垂電子科技股份有限公司 : 6C-03
KFE Hong Kong (株) : 6C-04
(株)松和産業 : 5i-06

プリント配線板・その他

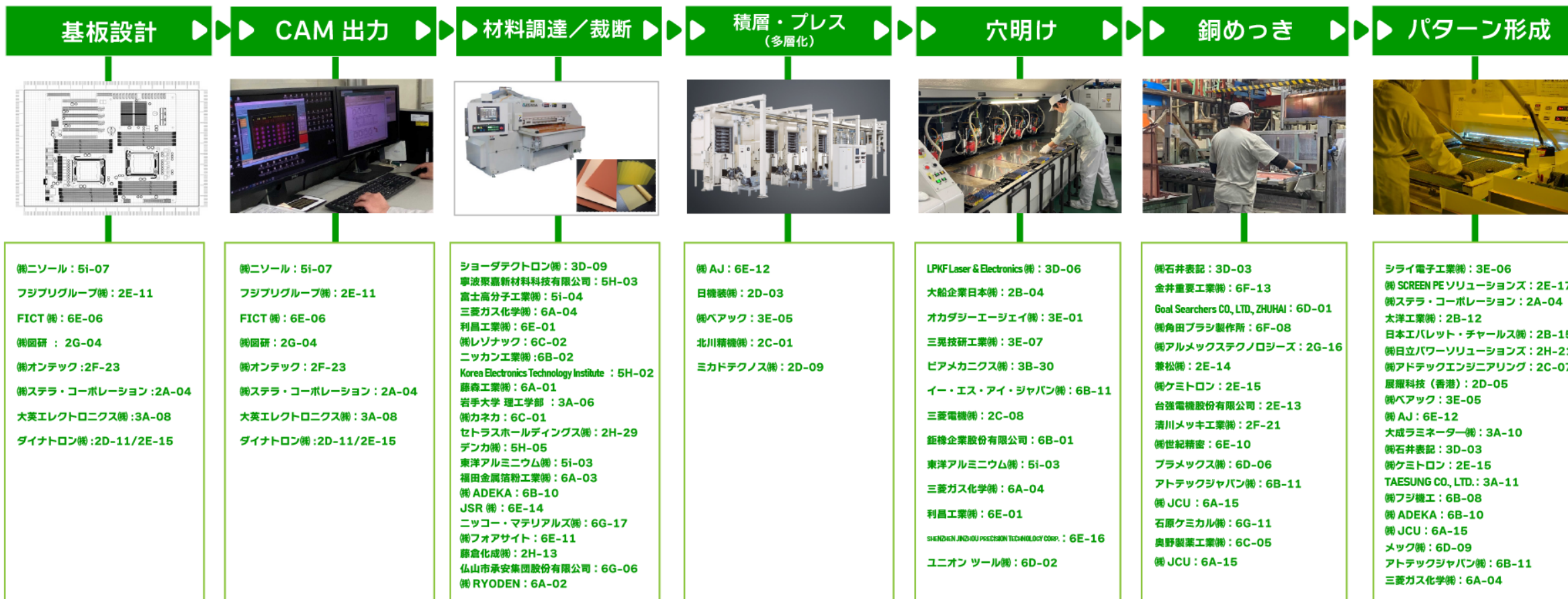
(株)アイン : 6F-11
アテネ(株) : 2H-08
NTW Inc. (株) : 6F-12
沖電線(株) : 5H-04
(株)シミズ : 6E-09
日東紡績(株) : 6F-01

各プロセス出展者

画像提供：(株)メイコー様、ショーダテクトロン(株)様、(株)レゾナック様、北川精機(株)様、(株)ちの技研様

出展者名をクリックすると詳細が確認いただけます。

プロセス開始



次工程へ ▶▶▶

各プロセス出展者

画像提供：(株)の技研様、メイコー(株)様、ピアメカニクス(株)様、ヤマハファイナテック(株)様、(株)SCREEN PE ソリューションズ様、J-RAS (株)様、(株)フィッシャー・インストルメンツ様

出展者名をクリックすると詳細が確認いただけます。

プロセスエンド



各工程のチャートは以下でもご確認いただけます。

東3ホールの特設ブース「基板製造プロセス展示」(3i-03)でのパネル展示
 ⇒関連プロセスの出展者をじっくりとご確認いただくのにお勧め

東2ホールと東6ホールの各入り口でのデジタルサイネージを用いたナレーション入り動画
 ⇒ナレーション解説付きで理解を深めていただくのにお勧め

